

國家科學及技術委員會 函

地址：臺北市和平東路二段106號
聯絡人：胡秀娟 研究員
電話：02-2737-7560
傳真：02-2737-7607
電子信箱：jenhu@nstc.gov.tw

受文者：高雄市立空中大學

發文日期：中華民國112年7月12日
發文字號：科會科字第1120045440號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (112U0P009402_112D2019140-01.pdf、112U0P009402_112D2019142-01.pdf、112U0P009402_112D2019141-09.odt)

主旨：本會與德國聯邦教育研究部(BMBF)共同徵求2024年臺德半導體晶片設計學術合作研究計畫(1-3年期)，自2023年7月14日至9月5日止受理申請，請於申請截止日前完成線上申請並造冊函送本會，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

- 一、依據2023年3月21日本會與德國聯邦教育研究部(BMBF)簽署之科學及技術合作協議(STA)推動共同研究計畫。
- 二、臺方計畫主持人須符合本會專題研究計畫主持人及共同主持人資格，每一計畫主持人對本項徵件案僅限研提1件計畫構想書。
- 三、本公告計畫之執行期程自2024年5月1日開始，以1-3年期計畫為原則，雙方共同研究計畫之執行期間須相同。申請須知詳如附件，同步於本會網站/動態資訊/計畫徵求公告，雙方申請主持人分別依本會及德方BMBF之規定辦理。

四、本案聯絡人：

(一)相關計畫內容詢問，請洽科國處胡秀娟研究員，電話：

空中大學 1120713



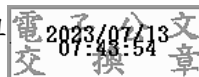
11230405600

(02) 2737-7560、陳嘉苓小姐，電話：(02) 2737-7682。工程處梁雁惠助理研究員 (02) 2737-7525

(二)線上作業系統操作問題，請洽國科會資訊系統服務專線，電話：0800-212-058，(02) 2737-7590、7591、7592。

正本：專題研究計畫受補助單位 (共301單位)

副本：本會工程處、科教國合處、駐德國代表處科技組



主任委員吳政忠

裝

訂

線

